

第2回 次世代電子実装システム技術講演会

2/17 木 15:00 - 17:20

定員 **100**名

対象 当該テーマに関心のある方は
どなたでもご参加いただけます

多様化するMore than Mooreの電子デバイスシステム集積技術に向けて、先端実装技術の産業分野への展開や次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会設立の情報をご提供します。

15:00-15:05

オープニング 青柳 昌宏氏

国立研究開発法人産業技術総合研究所
TIA推進センター

15:05-15:45 次世代パワーデバイス実装の技術課題



講師：佐藤 弘氏

国立研究開発法人産業技術総合研究所
先進パワーエレクトロニクス研究センター

2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、パワーエレクトロニクスに注目が集まっている。現在、主に使われているSiパワーデバイスでは、物性限界のため更なる省エネが難しく、SiC等次世代パワーデバイスの活用が有望である。しかし、単純な置き換えでは省エネは限定的で、極限の省エネ達成には、高温や高周波などの技術課題を克服した実装技術が必須と考えている。本講演では、この指針のもと、産総研で実施している、次世代パワーデバイスの極限性能発揮を目指した実装技術研究について紹介する。

プロフィール

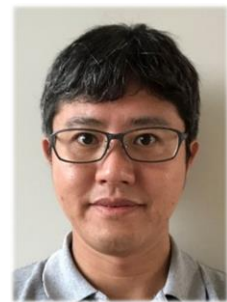
1991年通商産業省工業技術院電子技術総合研究所(現在の国立研究開発法人産業技術総合研究所)に入所。以降、酸化物高温超伝導体ジョセフソン接合、酸化物スピントネル接合、SiC等次世代パワー半導体の実装技術開発に従事。現在、先進パワーエレクトロニクス研究センター・パワー回路集積チーム・研究チーム長。

15:45-16:25 ポリマー光回路を用いた光電コパッケージ技術の研究開発

講師：天野 建氏

国立研究開発法人産業技術総合研究所
プラットフォームフォトンクス研究センター

高性能コンピュータの実効性能向上へ向けて、機器内のデータ伝送の広帯域化、低消費電力化が求められており、光素子を電子素子と同一パッケージ上に集積する光電コパッケージ技術が注目されている。本講演では我々が取り組んできたポリマー光回路を用いた光電コパッケージ技術を中心に技術動向と最新成果を紹介する。



16:25-17:05 薄化した電子デバイス実装の近年の動向

多様化するMore than Mooreの電子デバイスシステム集積技術では半導体の高密度化を実現するため、薄化し、多層化した電子デバイスが注目されている。これら実装技術の近年の動向とこれら実装技術に対応するため、次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会について紹介する。

根本 俊介

KISTEC 電子技術部 電子デバイスグループ

17:05-17:15 総合質疑

17:15-17:20

エンディング 三橋 雅彦

KISTEC 電子技術部

次世代電子実装システム技術研究会(案)HPからお申し込み下さい。
<https://www.kistec.jp/nepstech/report/>

お申込みはこちら



お問い合わせ：電子技術部 電子デバイスグループ 根本俊介 E-mail: sm-electronic_devices_g@kistec.jp

主催：地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)